



2024年3月期 第1四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614
2023年8月10日

売上高および各利益とも概ね計画以上の進捗

- 当第1四半期は半導体市場環境の影響を保守的に予想していたが、大きな影響は受けなかったため予想を上回る進捗。当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があるが、進捗率についても順調にスタート。
- 売上高は、電子システム事業が前期に引き続き堅調、材料納期遅延の影響を最小限に抑え、計画比及び前期比でも増収。
- 経常利益は、高付加価値製品への取り組み、価格転嫁及び調達コスト等の削減により、計画比及び前期比でも増益。従来から下期のウェイトが高いが、通期での進捗率は30.0%と順調。（前期比+17.3%）
- 受注は引き続き好調であるが、下期に向けた市場環境を考慮し、業績見通しは据え置く。

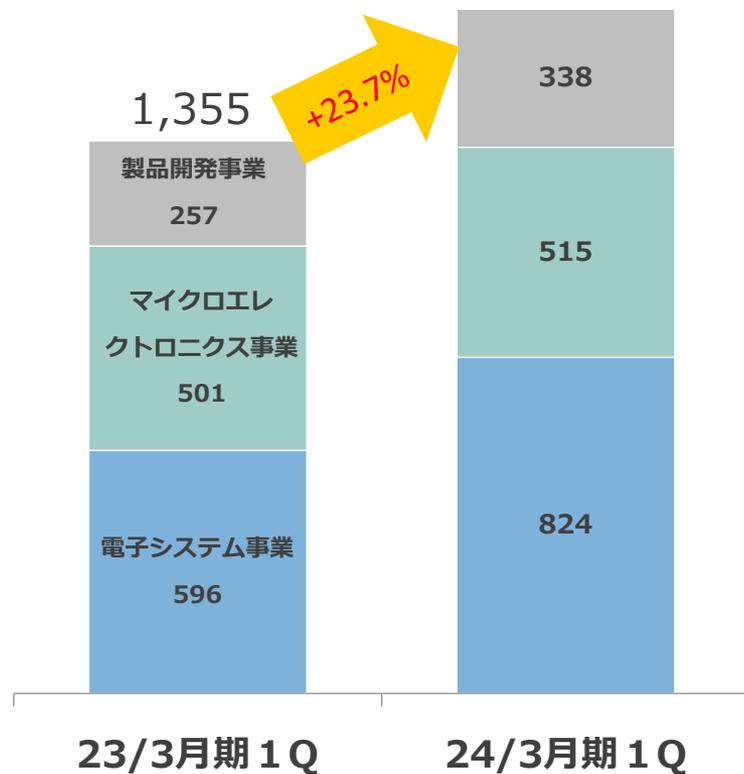
(単位：百万円、%)

	2024/3期 通期予想		2024/3期 1Q実績		計画比	前年同期比
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率	増減率
売上高	6,680	100	1,677	100	25.1	23.7
販管費	1,413	21.2	289	17.3	20.5	6.3
営業利益	560	8.4	160	9.6	28.7	224.7
営業利益率	8.4		9.6		—	6.0
経常利益	560	8.4	168	10.0	30.0	205.9
当期純利益	430	6.4	118	7.1	27.7	252.7

半導体生産増による半導体後工程商材、新製品用カスタムバーンインの受注及び車載製品用専用計測機器の受注が増加し、電子システム事業が大幅増収。
マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業も堅調に推移。

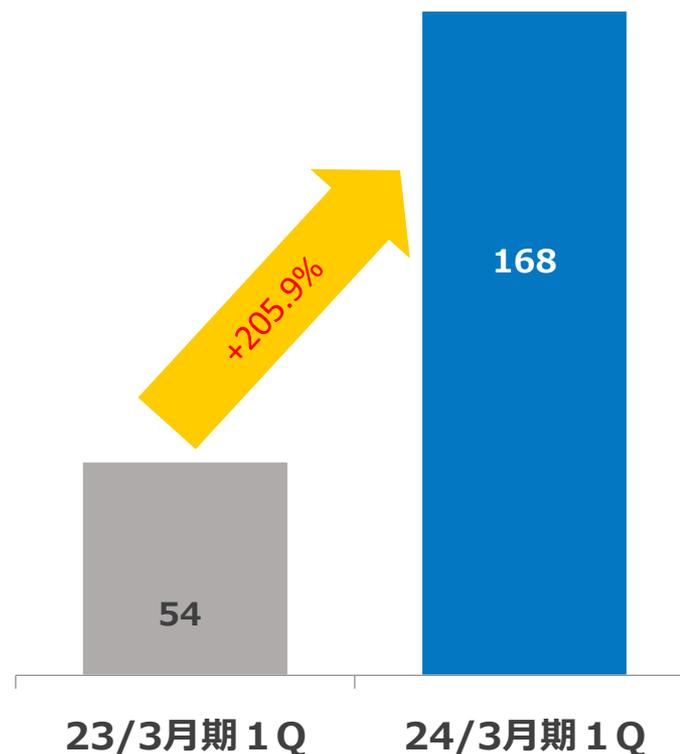
【売上高】

(単位：百万円)
1,677



【経常利益】

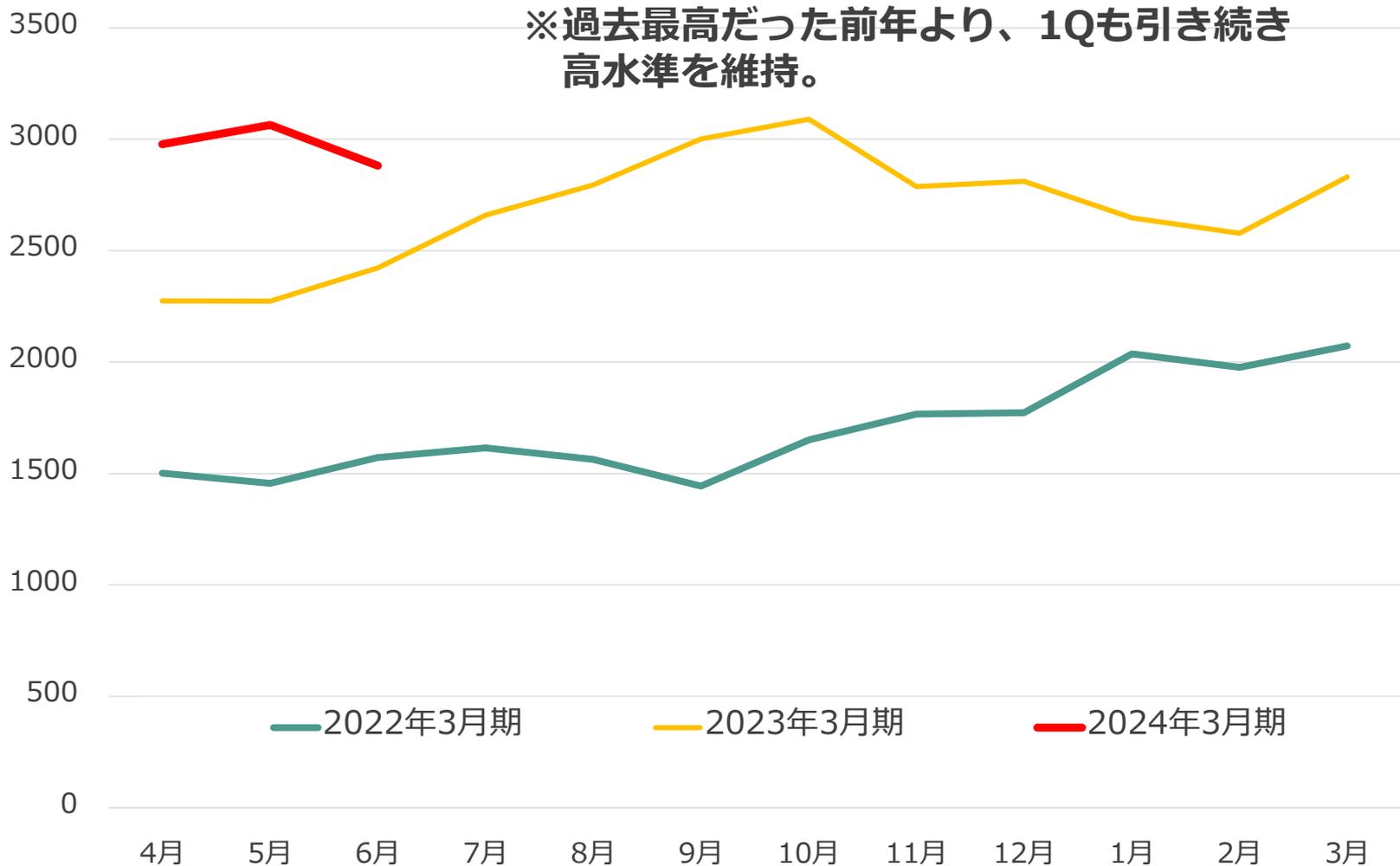
(単位：百万円)

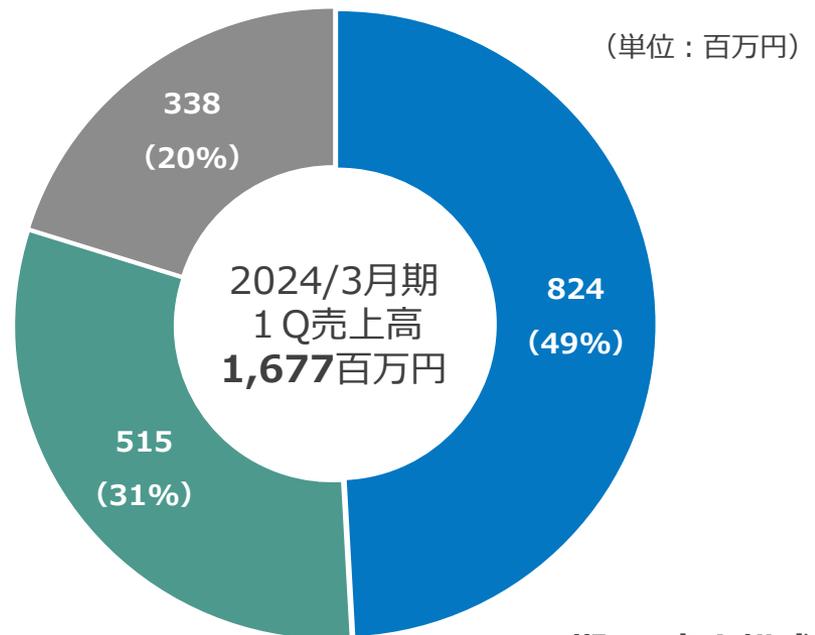


※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

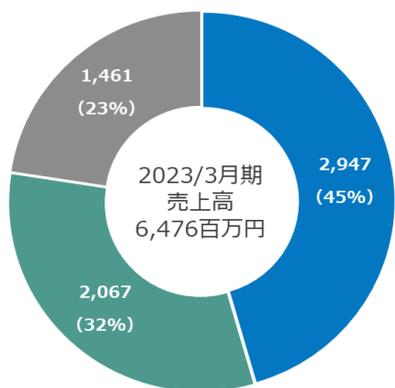
【受注残高（全社）】

(単位：百万円)





24/3月期1Q売上構成



(参考) 23/3月期売上構成

電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

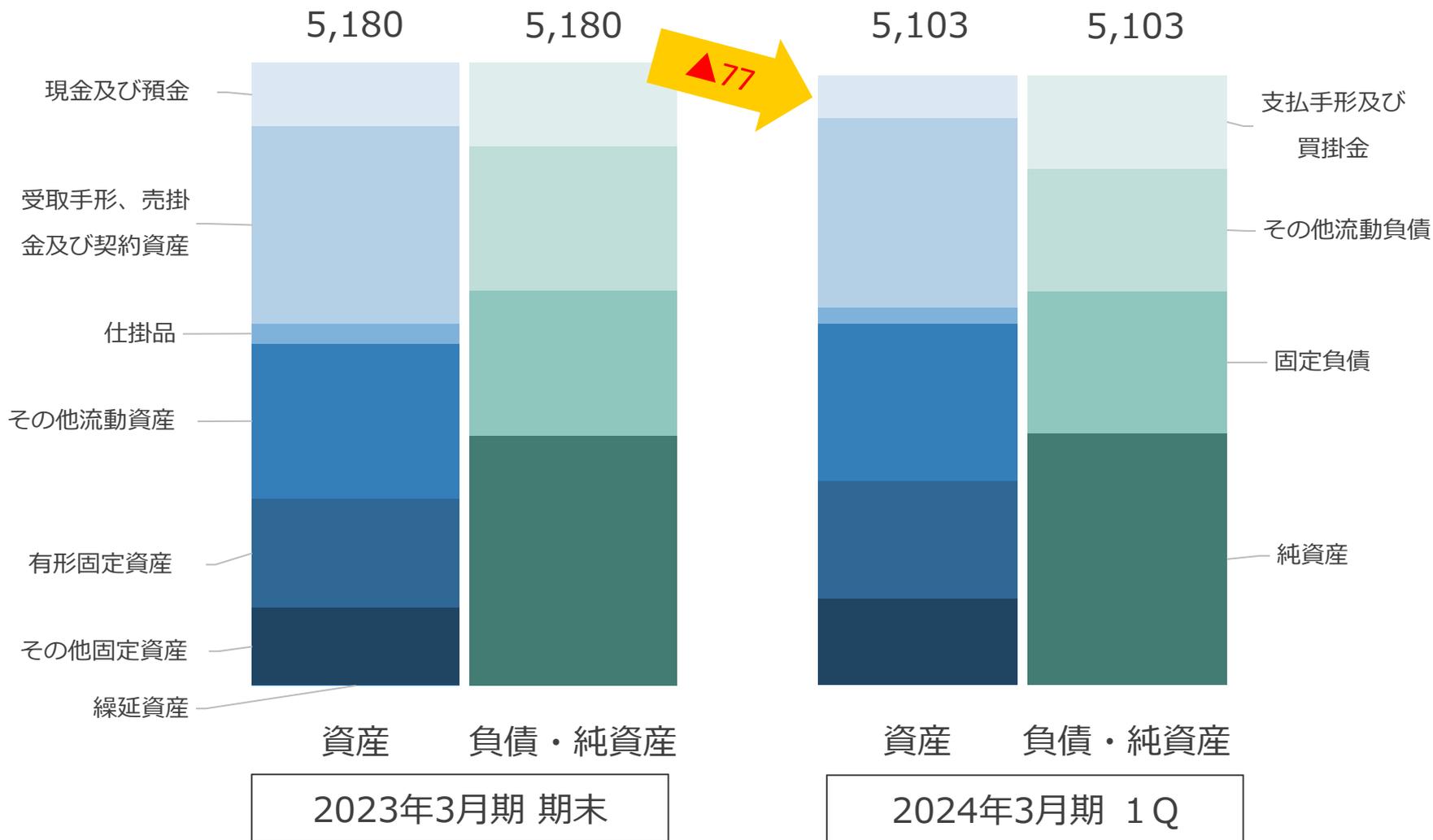
組み込みカメラモジュール・画像システム

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

【流動資産】 前期末の売掛回収で売掛債権減少、部材の先行調達による原材料等増加。

【流動負債】 短期借入金減少。

【純資産】 自己株式取得したが、着実な利益計上で純資産増加。自己資本比率+1.1ポイント。



2023年

4月 5日 第32回 Japan IT Weekに出展
~7日

4月17日 130万画素MIPI出力カメラモジュール ルネサス製RZファミリのドライバの提供開始

5月11日 決算発表

剰余金の配当（増配）をリリース

5月24日 富山県魚津市の第二工場の稼働開始

5月22日 譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議

6月 8日 決算説明会

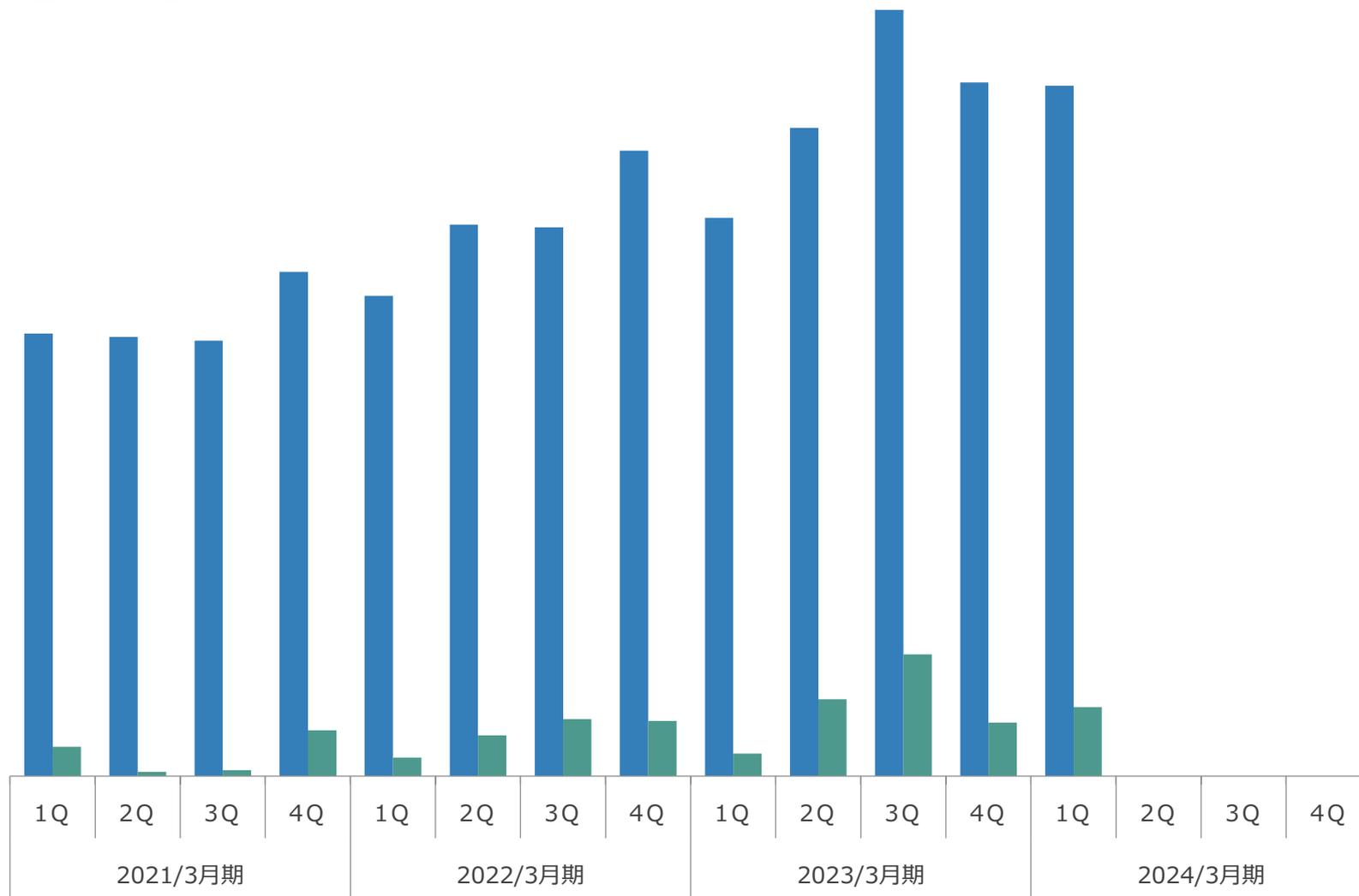
6月28日 第51期 定時株主総会

7月 5日 スーパーフレックスタイム制の導入

1Q

2Q

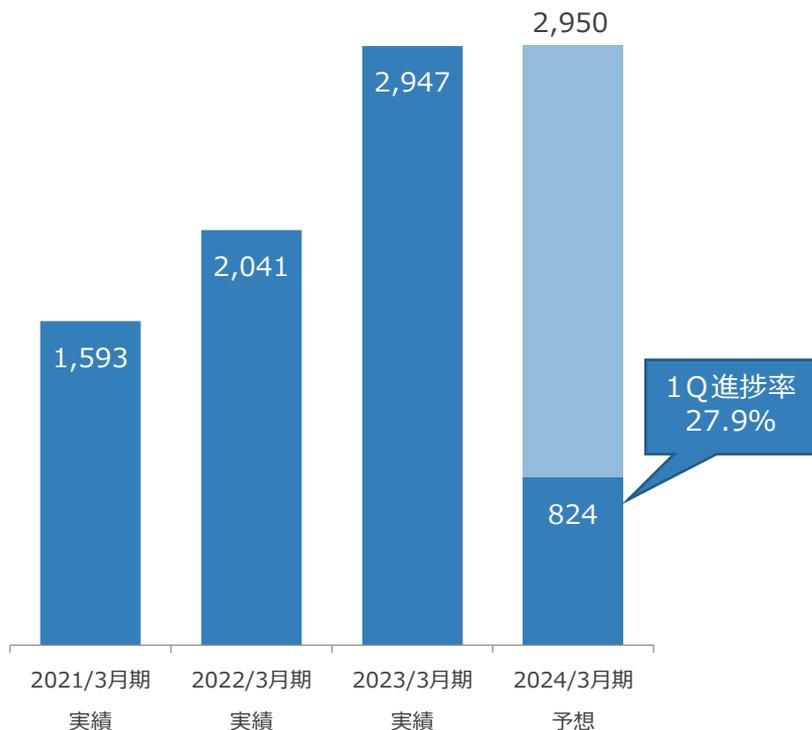
■ 売上高 ■ 経常利益



半導体生産増に対する後工程商材の受注増、半導体新製品用カスタムバーンイン商材の受注増に加え、車載製品用専用計測機器の受注が堅調。

【売上高】

（単位：百万円）



1Qトピックス

➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注増



バーンインボード
前期1Q比：137%



半導体検査装置販売・リース
前期1Q比：236%



車載製品用専用計測機器関連
前期1Q比：102%

➤ 魚津第二工場の改修完了。
5月24日より稼働開始。



HD-PLC

➤ HD-PLC製品を展示会に出展



Japan IT Week春

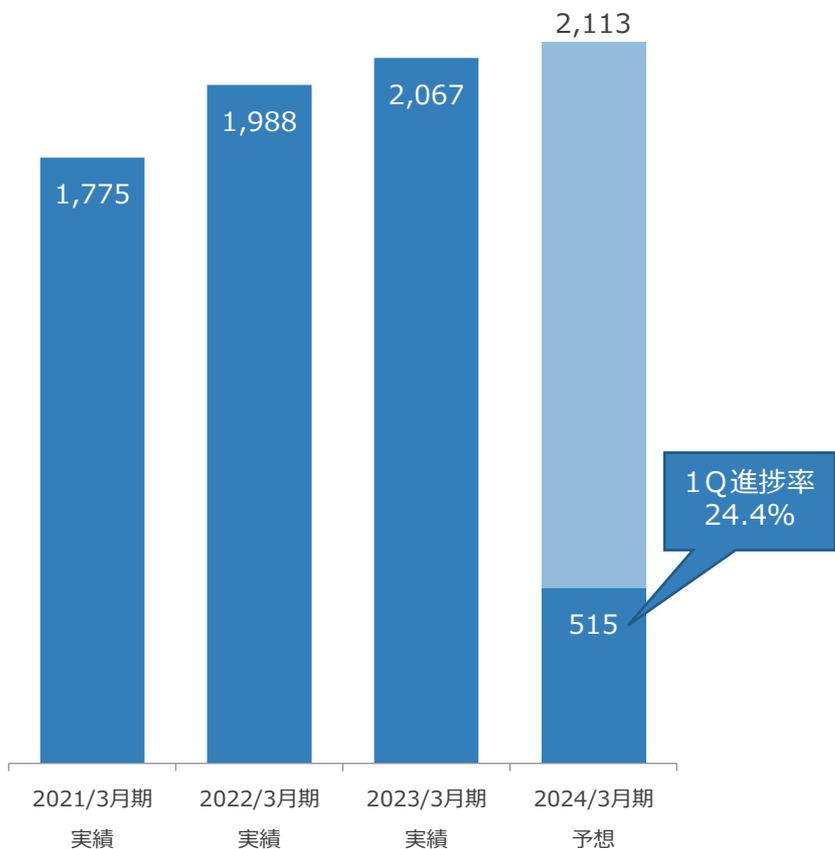


ものづくりAI/IoT展に出展

アナログはセンサー用半導体の設計が微減も自動車向けパワー半導体の設計が順調に推移。
デジタルはDSC画像処理関連の設計需要がピークアウトし、自動車向け設計受託が好調。

【売上高】

(単位：百万円)



1Qトピックス

➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年同期比：106%



センサー用半導体
前年同期比：93%



➤ デジタル半導体設計受託

DSC等画像処理関連
前年同期比：75%



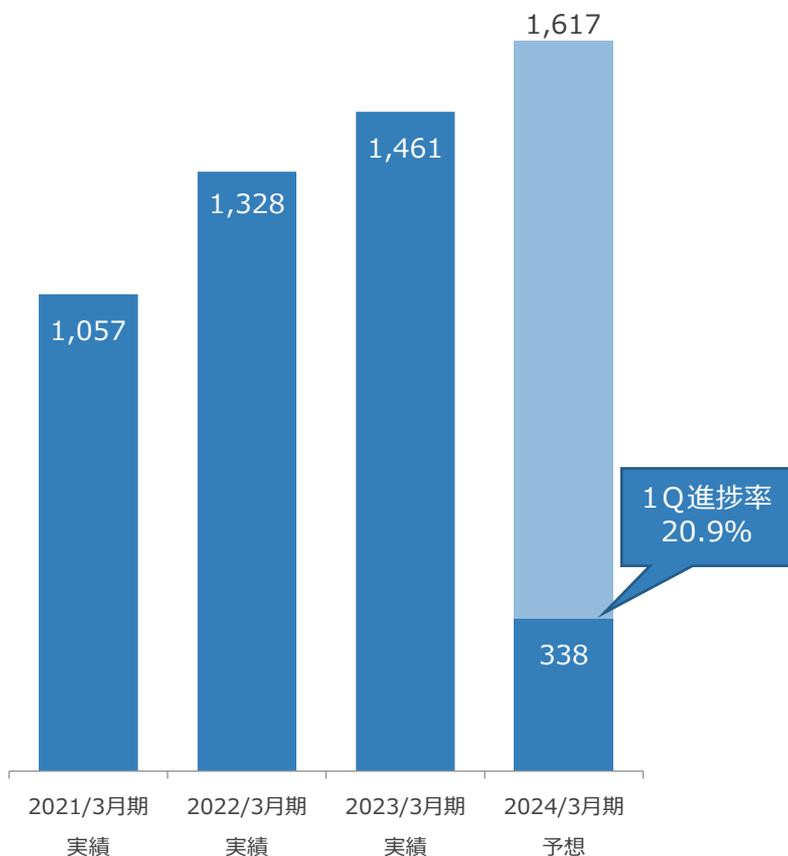
自動車関連デジタル設計
前年同期比：281%



堅調な海外ATM、セルフレジなどのインフラ向けカメラ製品に加え、券売機などの産業機器向け製品が復調、また、エレベータ向けカメラ製品の量産を開始。

【売上高】

(単位：百万円)



1Qトピックス

インフラ向け
組込カメラモジュール
前年同期比：146%

Japan IT Week(春)
IoTソリューション展に出展 (4月)

3D

シキノハイテック
イメージングソリューション

認識認証

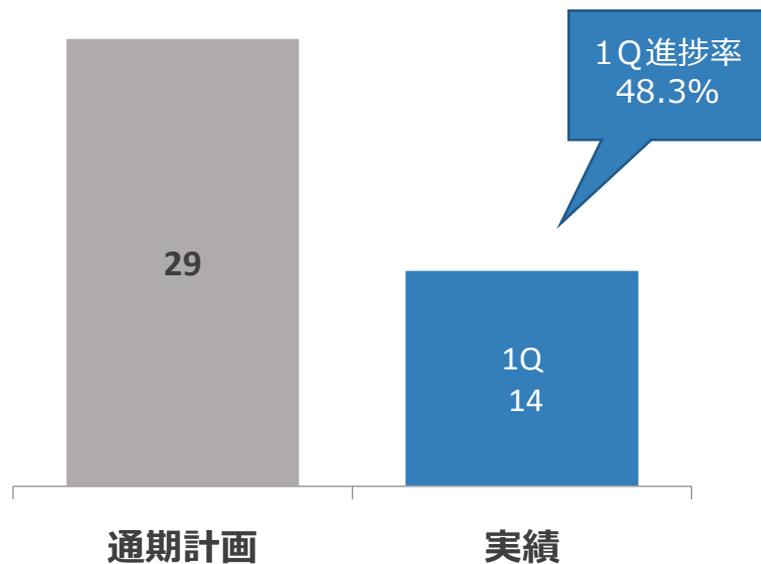
エッジ画像処理

HD-PLC通信

好調な受注環境と成長に対応するための人員増強を継続しております。
一部テーマの研究開発に若干の遅れ、2Q以降での挽回を図る。

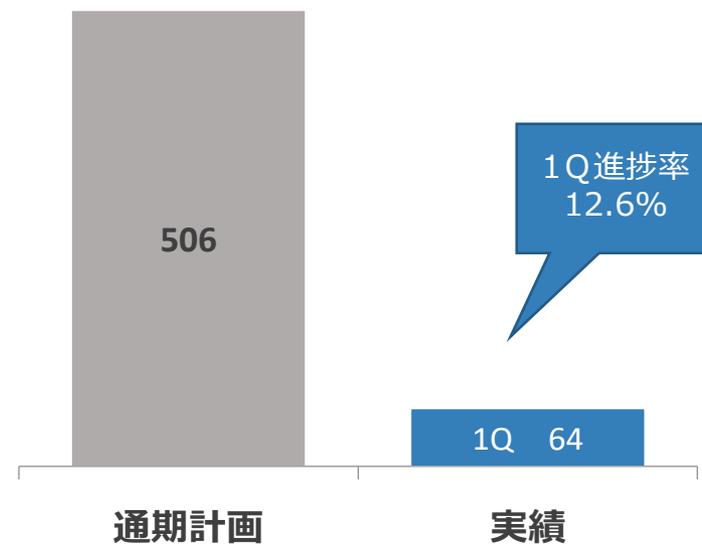
【人材採用】

(単位：人)



【研究開発費】

(単位：百万円)



顧客の未解決課題の解決、顧客ニーズの充足の視点で、競合他社に対して優位性のある技術・製品の開発に取り組みます。

研究開発分野

半導体検査装置、計測システム、
IPコア、高速IF回路、
画像処理システム、カメラの性能向上、
新機能開発

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
次世代IoT-PLC通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/